

特 許 協 力 条 約

REC'D 2 4 SEP 2004

WIPO PCT

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 KEM-118PCT	今後の手続きにつ	Oいては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP03/14001	国際出願日 (日.月.年) 3	1. 10. 2003	優先日 (日.月.年) 31.	10.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. 7 C30B29,	∕06, C30B1	5/04, C30B1	5/22, H01L2	1/322
出願人 (氏名又は名称) コマツ電子金属株式	会社			t
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条)の 2. この国際予備審査報告は、この表紙を	規定に従い送付す	వ .	・備審査報告である。 からなる。	,
3. この報告には次の附属物件も添付され			<i>∾-</i> 545°	
補正されて、この報告の基礎 囲及び/又は図面の用紙(P	をとされた及び/又 CT規則70.16及び	はこの国際予備審査機関 *実施細則第607号参	が認めた訂正を含む! 照)	明細書、請求の範
第 I 欄 4 . 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙				
b 型 電子媒体は全部で(電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第802号参照)				
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。				
 ※ 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 第 IV 欄 発明の単一性の欠如 ※ \$ V 欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 第 VI欄 ある種の引用文献 第 第 MI欄 国際出願の不備 第 MI欄 国際出願に対する意見 				
国際予備審査の請求書を受理した日 国際予備審査報告を作成した日				
10.03.2004		07. 09. 2004		
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が閔三丁目4番3号		特許庁審査官(権限のある職員) 4G 2927 横山 敏志 電話番号 03-3581-1101 内線 3416		



特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP03/14001

After 9 July 1997 All	
第 I 欄 報告の基礎	•
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の官語を	基礎とした。
□ この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。 それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。 □ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査 □ PCT規則12.4にいう国際公開 □ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査	
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 (PCT14条) のた差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していな	規定に基づく命令に応答するために提出され い。)
出願時の国際出願書類	
※ 明細書 第 1-21 ページ、 出願時に提出された 第 ページ*、 ページ*、 第 ページ*、 ページ*、	もの 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
※ 請求の範囲 第	に基づき補正されたもの 4 付けで国際予備審査機関が受理したもの
X 図面 第 1-6 第 ページ/図*、 第 ページ/図*、	付けで国際予備審査機関が受理したもの もの 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。	
3. 補正により、下記の書類が削除された。	ページ
請求の範囲 第	ベージ 項 ページ/図
配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)	
4. この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとし	示した補正が出願時における開示の範囲を超 て作成した。 (PCT規則70.2(c))
□ 明細書 第 □ 請求の範囲 第 □ 図面 第 □ 配列表(具体的に記載すること) ■ □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) ■	ページ 項 ページ/図
* 4. に該当する場合、その用紙に"superseded"と記入されることがある。	•
<u> </u>	



特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP03/14001

有

第V欄 新規性、進歩性又 それを裏付ける文	は産業上の利用可能性についての法	第12条 (РСТ35条(2)) に定める	5見解、
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1-10	
進歩性(IS)	請求の範囲	1-10	有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

産業上の利用可能性 (IA)

文献1: EP 1069214 A1 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO. LTD.) 2001.01.17

文献2: WO 01/88230 A1 (信越半導体株式会社) 2001.11.22

請求の範囲

請求の範囲

文献3: JP 2001-39797 A (三菱マテリアルシリコン株式会社 外1名) 2001.02.13

(請求の範囲1-7)

- 請求の範囲1-7に記載された発明は、国際調査報告書に引用された文献1-3に対し て進歩性を有する。

文献1-3には、無欠陥エピ欠陥領域(α2)の下限ライン(LN1)で示されるシリコン結晶中のボロン濃度と成長条件V/Gとの間の一定関係を境界条件として、シリコン結晶中のボロン濃度と成長条件V/Gを制御することが記載されておらず、しかもその点は、文献1-3に記載された、V/Gを制御することから当業者といえども容易に想到し得ないものである。 (請求の範囲8)

…請求の範囲8に記載された発明は、国際調査報告書に引用された文献1-3に対して 進歩性を有する。

文献1-3には、シリコン結晶中のボロン濃度と成長条件V/Gを制御するとともに、シリコン結晶中の酸素濃度を12.5atoms/cm³以下に制御することが記載されておらず、しかもその点は、文献1-3に記載された、V/Gを制御することから当業者といえども容易に想到し得ないものである。(請求の範囲9.10)

請求の範囲9,10に記載された発明は、国際調査報告書に引用された文献1-3に対して進歩性を有する。

文献1-3には、無欠陥エピ欠陥領域(α1)内の下限ライン(LN3)近傍になるように、シリコン結晶中のボロン濃度と成長条件V/Gを制御することが記載されておらず、しかもその点は、文献1-3に記載された、V/Gを制御することから当業者といえども容易に想到し得ないものである。

請求の範囲

1. (補正後)シリコンウェーハ基板で無欠陥かつエピタキシャル成長層で無欠陥となる無欠陥領域であって、シリコン結晶中のボロン濃度が 1×10^{18} atoms/ cm^3 以上でボロン濃度が上昇するにしたがい成長速度Vが徐々に低下するラインを下限ライン(LN1)とする無エピ欠陥領域($\alpha2$)内に入り、かつ、シリコンウェーハ基板で転位ループクラスタが顕れエピタキシャル成長層で欠陥が顕れるエピ欠陥領域であって、前記下限ライン(LN1)を上限ラインとするエピ欠陥領域($\beta2$)に入らないように、

前記無エピ欠陥領域(α2)の下限ライン(LN1)で示されるシリコン結晶中のボロン濃度と成長条件V/G(V:成長速度、G:結晶の軸方向温度勾配)との間の一定の関係を境界条件として、シリコン結晶中のボロン濃度と成長条件V/G(V:成長速度、G:結晶の軸方向温度勾配)を制御して、シリコン結晶を製造するシリコン結晶製造工程と、

前記シリコン結晶からシリコンウェーハ基板を採取するシリコンウェーハ基板 採取工程と、

前記シリコンウェーハ基板の上にエピタキシャル成長層を形成するエピタキシャル成長工程と

を含むシリコンウェーハ製造方法。

2. (補正後)前記シリコン結晶製造工程では、シリコン結晶の結晶中心から結晶端までが無エピ欠陥領域 (α2)の下限ライン (LN1)を下回らない程度に、シリコン結晶の軸方向温度勾配Gを、結晶中心から結晶端の間で均一に制御すること

を特徴とする請求の範囲1記載のシリコンウェーハの製造方法。

3. (補正後)前記シリコン結晶製造工程では、シリコン結晶が引き上げられるシリコン融液に磁場を印加することによって、シリコン結晶の軸方向温度勾配Gを、結晶中心から結晶端の間で均一に制御すること

を特徴とする請求の範囲2記載のシリコンウェーハの製造方法。

4. (補正後) 前記シリコン結晶製造工程では、シリコン結晶が引き上げられるシリコン融液を、無磁場の状態とし、かつシリコン結晶の回転数を制御すること



によって、シリコン結晶の軸方向温度勾配Gを、結晶中心から結晶端の間で均一 に制御すること

を特徴とする請求の範囲2記載のシリコンウェーハの製造方法。

5. (補正後) 前記シリコン結晶製造工程では、シリコン結晶が引き上げられるシリコン融液を、無磁場の状態とし、かつシリコン融液が収容される石英るつぼの回転数を制御することによって、シリコン結晶の軸方向温度勾配Gを、結晶中心から結晶端の間で均一に制御すること

を特徴とする請求の範囲 2 記載のシリコンウェーハの製造方法。

6. 前記シリコン結晶製造工程では、シリコン結晶中の酸素濃度が 1 2. 5 atoms/ c m³以下に制御されること

を特徴とする請求の範囲1記載のシリコンウェーハの製造方法。

7. 前記シリコン結晶製造工程では、シリコン結晶中の酸素濃度が 12. 5 atoms/ c m 3 以下に制御されること

を特徴とする請求の範囲2記載のシリコンウェーハの製造方法。

8. (補正後)シリコンウェーハ基板でOSF(酸化誘起積層欠陥)が顕れエピタキシャル成長層で欠陥が顕れるエピ欠陥領域(β 1)を少なくとも含むように、シリコン結晶中のボロンの濃度と成長条件V/G(V:成長速度、G:結晶の軸方向温度勾配)を制御するとともに、OSF核がOSFに顕在化しないように、シリコン結晶に熱処理を施し、シリコン結晶中の酸素濃度を12.5 atoms/c m 3 以下に制御すること

を特徴とするシリコンウェーハの製造方法。

9. シリコンウェーハ基板でボイド欠陥が顕れエピタキシャル成長層で無欠陥となる無エピ欠陥領域 (α1) 内の下限ライン (LN3) 近傍になるように、シリコン結晶中のボロン濃度と成長条件V/G (V:成長速度、G:結晶の軸方向温度勾配)を制御して、シリコン結晶を製造するシリコン結晶製造工程と、

前記シリコン結晶からシリコンウェーハ基板を採取するシリコンウェーハ基板 採取工程と、

前記シリコンウェーハ基板の上に、2 μ m以下の薄膜のエピタキシャル成長層 を形成するエピタキシャル成長工程と



を含むシリコンウェーハ製造方法。

- 10. 前記シリコン結晶製造工程では、シリコン結晶中の酸素濃度が12.
- 5 atoms/ c m³以下に制御されること

を特徴とする請求の範囲 9 記載のシリコンウェーハの製造方法。







PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

1 1 1					
Applicant's or agent's file reference KEM-118PCT	FOR FURTHER A	CTION	See Form PCT/IPEA/416		
International application No. International filing d PCT/JP2003/014001 31 October 20		ate (day/month/year) 03 (31.10.2003)	Priority date (day/month/year) 31 October 2002 (31.10.2002)		
International Patent Classification (IPC) or n C30B 29/06, 15/04, 15/22, H01L	ational classification a		31 October 2002 (31.10.2002)		
Applicant KOMATS	Applicant KOMATSU DENSHI KINZOKU KABUSHIKI KAISHA				
This report is the international prelir Authority under Article 35 and trans	ninary examination rependent	port, established by this according to Article 3	s International Preliminary Examining 6.		
This REPORT consists of a total of This report is also accompanied by A			sheet.		
	· •	=	sheets, as follows:		
sheets of the descri	a (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of sheets, as follows: sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the				
sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.					
b. (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) , containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).					
4. This report contains indications relat	ing to the following ite	ems:			
Box No. I Basis of the re	Box No. I Basis of the report				
Box No. II Priority	Box No. II Priority				
Box No. III Non-establishr	ment of opinion with re	egard to novelty, invent	tive step and industrial applicability		
Box No. IV Lack of unity of invention					
Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
Box No. VI Certain documents cited					
Box No. VII Certain defects in the international application					
Box No. VIII Certain observations on the international application					
Date of submission of the demand Date of completion of this report			of this report		
10 March 2004 (10.03.2004)		07 September 2004 (07.09.2004)			
Name and mailing address of the IPEA/JP		Authorized officer			
Facsimile No.		Talanhana Na			

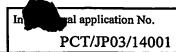


INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.
PCT/JP2003/014001

Box No.	<u> </u>	Basis of the report	
1. With other	regard wise ir	to the language, this report is based on the international application in the landicated under this item.	guage in which it was filed, unless
	This whic	report is based on translations from the original language into the following h is language of a translation furnished for the purpose of:	g language,
		international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))	
		publication of the international application (under Rule 12.4)	
İ		international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)	
and a	re not The in	received by this Authority onaims:	d to in this report as "originally filed" , as originally filed/furnished, as originally filed/furnished, as originally filed/furnished ether with any statement) under Article 19
i	pages		16 July 2004 (16.07.2004)
	the dr	awings:	
_	pages	1-6	
	pages		, as originally filed/furnished
	pages		
	a sem	ence listing and/or any related table(s) — see Supplemental Box Relating to See	
	The ar	the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/figs the sequence listing (specify): any table(s) related to sequence listing (specify):	questo Sisting.
	made, (Rule	eport has been established as if (some of) the amendments annexed to this resince they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as 70.2(c)). the description, pages	eport and listed below had not been indicated in the Supplemental Box





	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement		
1. Statement			
Novelty (N)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations (Rule 70.7)

Document 1: EP, 1069214, A1 (Shin-Etsu Handotai Co., Ltd.), January 17, 2001 (01.17.01)

Document 2: WO, 01/88230, A1 (Shin-Etsu Handotai Co., Ltd.), November 22, 2001 (11.22.01)

Document 3: JP, 2001-39797, A (Mitsubishi Materials Silicon Corp., et al.), February 13, 2001

(02.13.01)

Claims 1-7

The inventions described in claims 1-7 appear to involve an inventive step over documents 1-3 cited in the ISR.

Documents 1-3 do not describe setting a prescribed relationship between boron concentration in a silicon crystal indicated by a lower limit line (LN1) in an epitaxial defect-free region (α2) and growth condition V/G as a boundary condition, and controlling the boron concentration in a silicon crystal and the growth condition V/G. Further, such points could not be easily conceived of by a party skilled in the art based on control of V/G described in documents 1-3.

The invention described in claim 8 appears to involve an inventive step over documents 1-3 cited in the ISR.

Documents 1-3 do not describe controlling boron concentration in a silicon crystal and growth condition V/G, and controlling oxygen concentration in a silicon crystal at 12.5atoms/cm³ or less. Further, such points could not be easily conceived by a party skilled in the art based on control of V/G described in documents 1-3.

Claims 9 and 10

The inventions described in claims 9 and 10 appear to involve an inventive step over documents 1-3 cited in the ISR.

Documents 1-3 do not describe controlling boron concentration in a silicon crystal and growth condition V/G so that they fall in the vicinity of a lower limit line (LN3) in an epitaxial defect-free region (α 1). Further, such point could not be easily conceived by a party skilled in the art based on control of V/G.